

國產存儲雙雄正式邁入明牌擴張階段，其中長江存儲啟動 IPO 輔導工作，2026 年一季度營收突破 200 億元，同比大增 100%，長鑫科技同期營收高達 508 億元，同比漲幅 719.13%，歸母淨利潤 247.62 億元，亮眼業績充分印證行業整體高景氣度；存儲行業大規模擴產浪潮下，擴產資本開支中約八成資金流向設備採購，疊加半導體設備國產化率正從 20%-30% 穩步向 50%-60% 邁進，設備產業鏈順勢迎來量價齊升的發展黃金週期；與此同時，國家層面持續強調科技自立自強與產業鏈自主可控，疊加存儲龍頭 IPO 提速有效提振市場做多情緒，AI 半導體優質科技資產持續受到主流資金追捧，整體政策與市場形成強勢共振；在此背景下行業投資主線已然清晰，建議緊抓存儲擴產與國產替代兩大核心方向，優先佈局深度切入半導體龍頭供應鏈、擁有深厚技術壁壘的優質半導體設備企業。

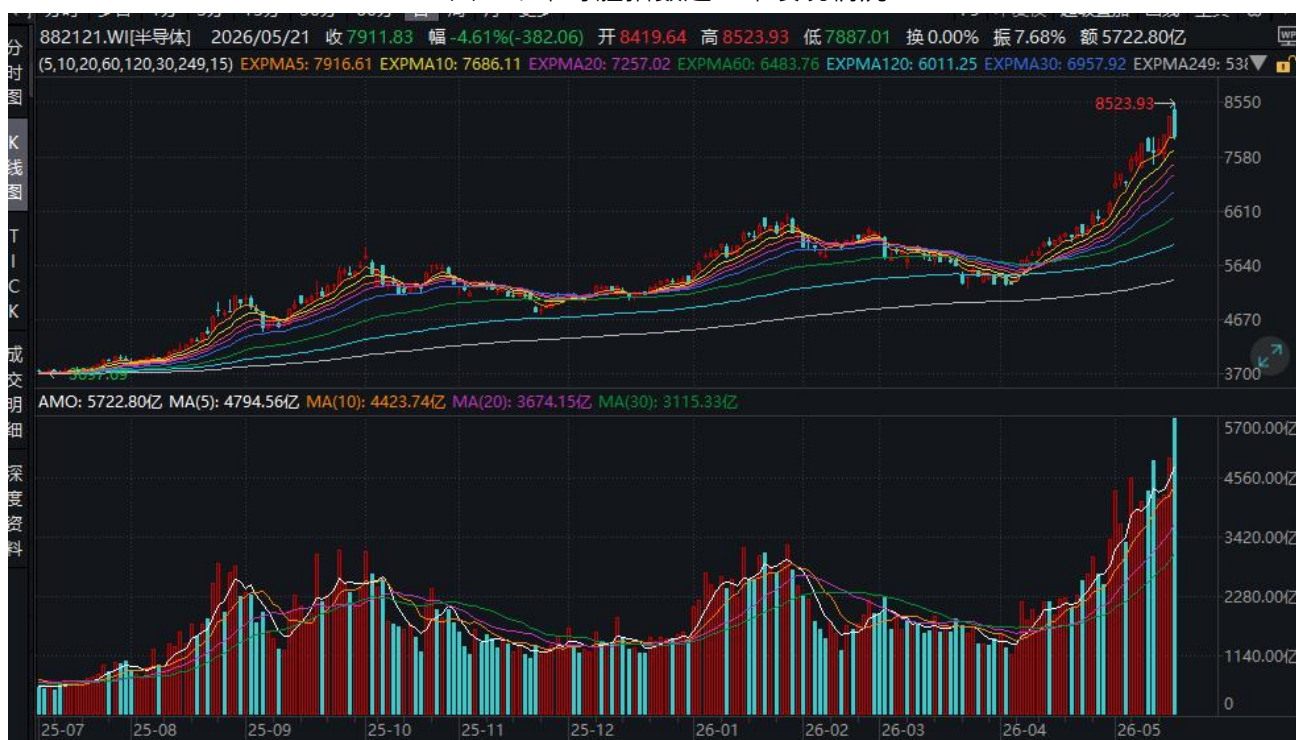
國產存儲雙雄引領擴產浪潮，半導體設備產業鏈迎來黃金發展期

據媒體消息，長江存儲已啟動 IPO 輔導工作，2026 年一季度營收突破 200 億元，同比實現翻倍增長，全球市場份額穩步攀升至行業第三位。長鑫科技業績表現更為亮眼，今年一季度營收達 508 億元，同比大漲 719%，歸母淨利潤接近 248 億元，根據上交所安排，公司將於 5 月 27 日迎來首發上市審議，同時企業預判 2026 年上半年營收與淨利潤均將迎來數倍暴漲，此次 IPO 擬募資 295 億元，全部用於產線升級、存儲技術優化及前沿技術研發，兩大國產存儲龍頭正式邁入規模化擴張新階段。

存儲產業持續加碼擴產，行業資本開支中約八成資金用於設備採購，疊加半導體設備國產化率從 20%-30% 加速提升至 50%-60%，直接推動設備產業鏈景氣度持續上行。在國家大力推進科技自立自強、保障產業鏈自主可控的政策導向下，存儲企業上市提速進一步點燃市場投資情緒，AI 半導體賽道備受資金青睞，帶動滬深及港股晶片標的走強，兆易創新 (3986.HK) 屢創歷史新高，中芯國際 (0981.HK)、華虹半導體 (1347.HK) 走勢強勁。政策與市場形成強勁共振，當前行業投資方向十分明確，建議緊盯存儲擴產與國產替代兩大主線，重點佈局深度綁定晶片龍頭供應鏈、具備高技術壁壘的優質半導體晶片及設備企業。



圖一：半導體指數近一年表現情況



資料來源：Wind

► 核心驅動邏輯：政策+週期+AI 三重共振，支撐中長期產業持續高景氣

*政策強支撐：錨定科技自立自強，國產替代戰略地位持續拔高

2026 年《政府工作報告》將積體電路與人工智慧確立為新質生產力核心支撐，正式形成“芯為底座、智為引擎”的雙輪驅動格局。其中，積體電路位列新興支柱產業首位，依託全鏈條技術攻關與資金政策雙重保障，夯實產業硬體根基；人工智慧作為智能經濟核心引擎，持續拓展全域應用、升級算力基建、完善行業治理。兩大產業雙向賦能、迴圈共生，加速半導體國產替代與產業生態完善，推動行業規模與品質同步提升，助力國家科技自立自強與經濟高質量發展。同時，差異化政策導向將加劇行業信用分化：深耕核心賽道、技術壁壘高、契合戰略方向的頭部企業將持續獲得資源傾斜、信用優勢凸顯；而無核心技術、依賴外部供給、陷入同質化內卷的企業，政策支撐持續走弱，行業出清有望提速。

其明確兩大產業發展方向：一方面實施產業創新工程，培育積體電路、航空航太等新興支柱產業，鼓勵央企國企開放應用場景；另一方面推進“人工智慧+”行動，推廣智能終端與 AI 智能體落地，推動 AI 規模化商業化應用，培育智能經濟新業態。政策將積體電路定位為數字經濟與高端製造的核心算力底座，將人工智慧提升至智能經濟核心形態高度，推動兩大產業從獨立賽道，升級為“硬體底座-智能演算法-場景應用”的完整閉環，承擔起保障產業鏈安全、培育經濟新動能的雙重戰略使命。認為



以積體電路與人工智慧雙輪驅動培育新質生產力，晶片築牢產業硬體根基，人工智慧啟動數據要素價值，二者雙向賦能、互為支撐，構建產業發展良性迴圈，既夯實當下支柱產業，又前瞻佈局未來新興賽道，引領產業向高端化、智能化、綠色化轉型。而積體電路聚焦全產業鏈突破，攻堅先進制程、高端晶片、EDA 工具、光刻核心部件等關鍵技術，加速成熟制程擴產與國產替代；依託政策資金多重扶持加大產業投入，聯動各方打通供需管道，搭建一體化產業集群，穩固產業發展根基，穩步提升核心晶片自給率。人工智慧大力推進多領域“AI+”融合應用，孵化各類智能新興業態；持續完善智算、通信等數字基礎設施，夯實全域算力支撐；同步培育開源產業生態，健全行業規範治理，平衡技術創新與風險管控，全方位推動智能產業穩健發展。

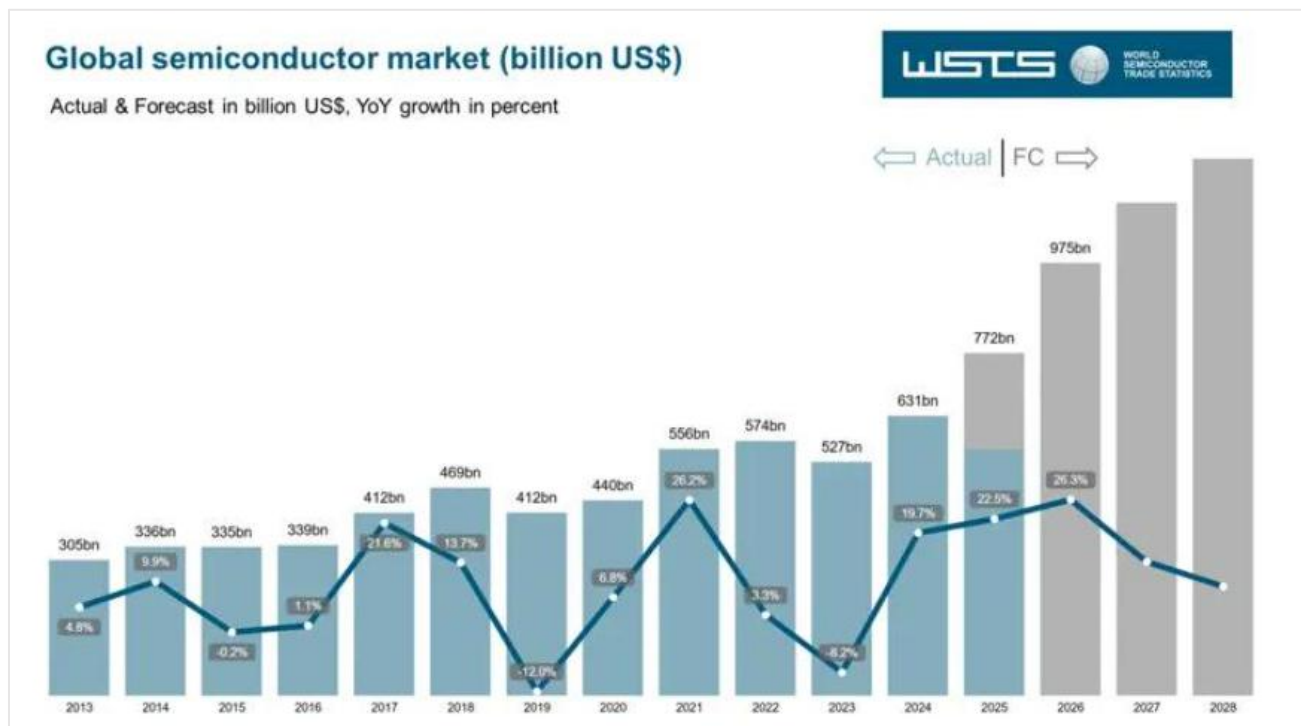
在政策影響上，從產業端來看，積體電路行業全面提速國產替代，成熟制程產能有序放量，先進制程研發攻堅持續加碼，產業鏈設備與材料自主化水準穩步攀升，行業規模不斷壯大，有望建成全球第三大晶片產業製造高地。人工智慧打破單一應用模式，加速全域行業融合滲透，智能體普及、開源生態完善、算電協同發展成為核心增長動力，依託智能經濟新業態，深度打通數字經濟與實體經濟融合發展路徑；企業端而言，積體電路企業迎來資金、應用場景、產業政策全方位扶持，深耕晶片設計、晶圓製造、封裝測試及上游設備材料賽道的企業率先享受發展紅利。人工智慧企業聚焦行業定制化方案、智能終端產品研發與開源生態構建，借助政策扶持拓寬市場管道，加快前沿技術落地落地，高效實現技術商業化與規模化應用。

*行業週期正式邁入上行通道，供需格局優化疊加存力需求迎來質變

當前全球半導體行業已徹底走出此前長達兩年的下行低谷，全面確立強勁的上行復蘇週期，數據上看，2026 年全球半導體市場規模預計將突破 9750 億美元，同比增長超 25%，其中存儲與邏輯晶片將成為增長核心引擎。與以往週期不同，本輪復蘇並非單純依賴消費電子週期性回暖，而是由 AI 算力革命驅動的結構性增長，行業景氣度正從上游設備材料向下遊應用終端逐級傳導，形成“上游領漲、中游跟漲、下游回暖”的清晰傳導路徑，產業鏈各環節呈現明顯分化格局。



圖二：2026 年全球半導體市場規模預計



資料來源：WSTS

當前全球 AI 大模型技術保持高速迭代節奏，模型性能持續優化升級，海內外市場算力佈局熱潮不減，行業算力軍備競賽愈演愈烈，直接全面拉動高端 GPU、高性能 CPU 等核心算力晶片需求大增，同時帶動各類存儲產品、先進封裝技術以及各層級晶圓代工業務需求集中釋放，產業鏈上下游訂單充足、景氣度全面抬升。AI 產業高景氣行情持續升溫發酵，行業應用落地節奏不斷加快，算力、存力、晶圓代工三大核心賽道深度綁定，全產業鏈形成強勁聯動共振的上行格局。以英偉達為代表的全球頭部科技企業持續搭建完善成熟的算力產業生態，依託自身技術與市場優勢，順勢推動 800V 高壓直流供電架構、高帶寬 HBM 高端存儲、碳化矽功率半導體等前沿新興技術及配套硬體產品加速落地普及，順利構建起清晰順暢的產業傳導邏輯，打造出算力升級帶動存力規模擴容、存力技術革新倒逼晶圓製造工藝持續突破的正向發展迴圈，產業鏈協同賦能、聯動發展的效應愈發突出。

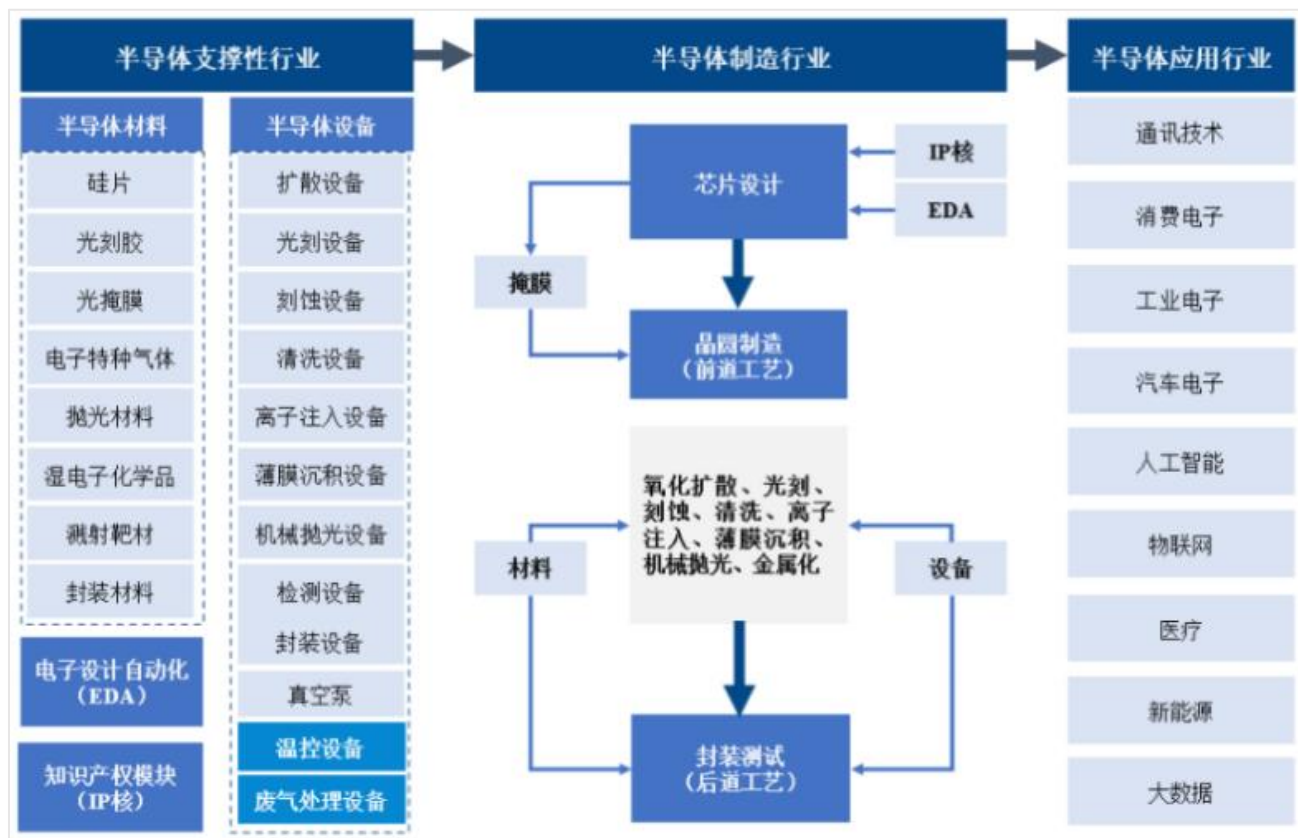
從上游端來看，上游半導體設備、半導體材料率先迎來需求爆發，成為週期復蘇的“先行指標”。設備領域中，光刻、刻蝕、薄膜沉積三大核心設備需求最為旺盛，尤其先進制程（7nm 及以下）設備訂單排期已延長至 2027 年，國產設備廠商在成熟制程領域的國產化率正快速提升至 30% 以上。材料方面，矽片、光刻膠、電子氣體、濕化學品等關鍵材料需求同步激增，韓國無水氫氟酸商近期開始從中國採購，標誌著國產半導體材料在全球供應鏈中的地位持續提升。

在中游環節，存儲晶片與先進封裝賽道率先迎來業績拐點，功率半導體、模擬晶片等細分品類緊隨其後。先進封裝作為突破摩爾定律的關鍵技術路徑，3D 堆疊、Chiplet 等工藝在 AI 晶片領域的應用推



動相關企業訂單量同比增長超 50%；功率半導體受益於新能源汽車與光伏儲能需求增長，SiC/GaN 等第三代半導體材料加速滲透；模擬晶片則憑藉高壁壘、高毛利特性，成為行業復蘇中的“穩定器”。

圖三：半導體產業鏈情況



資料來源：上市公司招股說明書

以存儲行業為例，全球存儲行業自 2025 年 Q3 完成行業築底，市場庫存經過連續 6 個季度的去化已降至健康水準，DRAM、NAND 閃存產品價格自 2025 年下半年起進入穩步上行通道，其中 DDR5 記憶體價格累計漲幅超 40%，3D NAND 閃存價格漲幅超 25%。傳統消費電子、終端硬體需求穩步回暖，2026 年全球智能手機出貨量預計增長 5%，PC 出貨量增長 3%，為存儲行業提供堅實基本盤支撐。而 AI 產業的飛速發展更是徹底重塑存儲行業需求結構，帶來“量價齊升”的雙重紅利。大模型訓練與推理落地、大型智算中心規模化擴容，催生高帶寬記憶體 HBM、大容量企業級 SSD 等高端存儲產品的剛性需求——AI 伺服器的存儲配置量為傳統伺服器的 3-5 倍，單臺 AI 伺服器 HBM 搭載量可達 128GB-512GB，是普通伺服器的 8-32 倍。HBM 作為 AI GPU 的“標配”，全球產能高度集中，SK 海力士、三星等國際巨頭訂單排期已至 2027 年，國內企業正加速佈局 HBM 封裝與測試領域。同時，AI 大模型對數據存儲的海量需求直接拉動通用 DRAM、消費級 NAND 市場需求持續放量，形成“高端引領、中低端跟進”的全面增長格局。



► 投資策略：結構性機會為主，把握節奏、精選賽道

整體半導體板塊以結構性行情為主，投資需精準把握市場節奏、聚焦優質賽道。板塊整體具備中長期持續佈局價值，但不存在普漲行情，操作上需分層把控：短期 1-3 個月板塊由情緒驅動、波動顯著放大，需謹慎追高，規避純情緒炒作的高位標的，耐心等待估值回調消化，同時重點跟蹤長鑫科技上會結果、長江存儲 IPO 推進進度及月度存儲價格核心數據；中期 3-12 個月，AI 算力景氣、存儲週期復蘇、國產產能擴產三重邏輯將持續兌現，成為板塊核心支撐；長期來看，國內存儲與晶圓製造自主可控進程持續深化，行業全球市場份額有望穩步提升，板塊長期配置價值十分突出。

結合行業發展趨勢，當前可重點佈局三大核心細分賽道。一是存儲晶片主線，作為行業核心投資方向，重點關注港股稀缺存儲設計標的兆易創新(3986.HK)，以及長鑫存儲、長江存儲上下游的參股、封測、材料等產業鏈標的如長電科技(600584.SH)，有研新材(600206.SH)等；二是晶圓代工賽道，聚焦覆蓋成熟與先進制程、承接 AI 及存儲代工訂單的中芯國際(0981.HK)，以及深耕特色工藝、主打功率與 MCU 晶片的華虹半導體(1347.HK)；三是 AI 算力配套賽道，涵蓋 HBM、先進封裝、半導體設備、EDA 等細分領域，充分受益於行業擴產浪潮與國產替代紅利。

但是投資過程中仍需警惕多重潛在風險，規避階段性回調壓力。首先是短期情緒退潮風險，長鑫科技上會、長江存儲 IPO 輔導落地屬於市場預期兌現節點，疊加板塊短期漲幅較大、估值偏高，容易引發資金獲利了結，導致板塊冲高回落、波動加劇；其次是外部地緣制裁風險，先進制程設備、光刻膠、EDA、高端存儲技術等領域受限，可能造成產能擴產、良率提升及 HBM 研發進度不及預期；最後是行業週期與競爭風險，存儲價格上行乏力、全球 AI 資本開支放緩、消費電子復蘇疲軟，將拖累行業整體景氣度，同時國內擴產不及預期、良率爬坡緩慢，疊加海外巨頭降價競爭，會進一步擠壓國內企業盈利空間。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

